

【事例】
CT撮影による
8層プリント基板銅箔パターン分離と
CAD化

2020年5月13日
(株) ビームセンス

手順

□ サンプル

- ◆ 45 x 50 mm 8層プリント基板

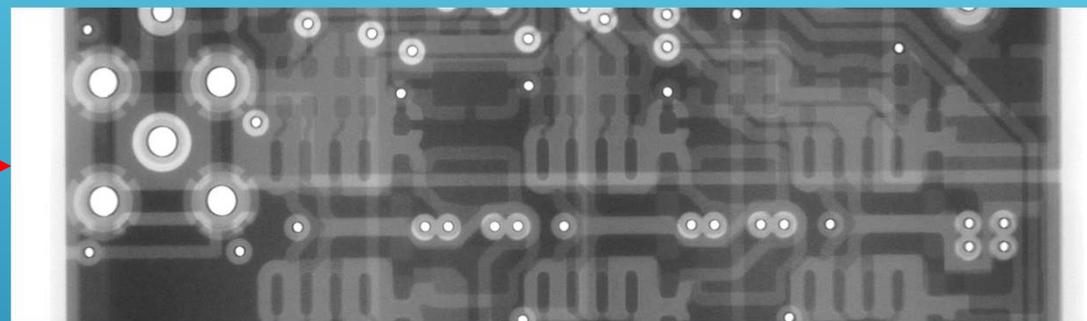
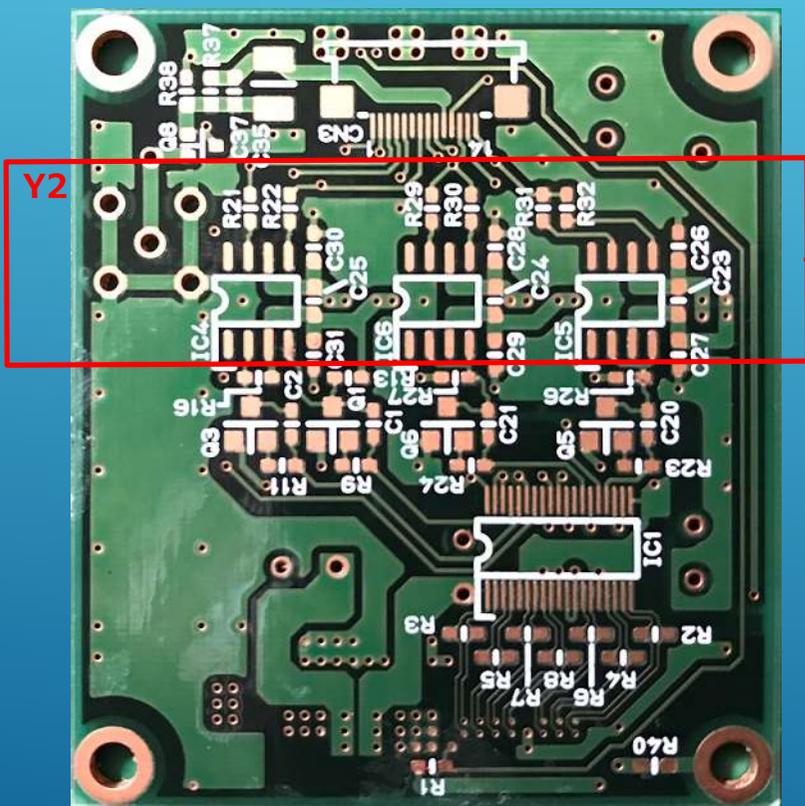
□ 撮影および3D X線像及び断層像作成

1. CT撮影：FLEX-MH867
4CCD結合、1.3倍、撮影範囲 45mm x 12mm
2. 3次元X線像作成：BSC Tソフト
再構成分解能 (15.4 μm /pixel)
3. Z軸方向XZスライス断層像作成
4. 2次元CADシステムにて図化

サンプルの光学画像とCT撮影位置および透過X線像

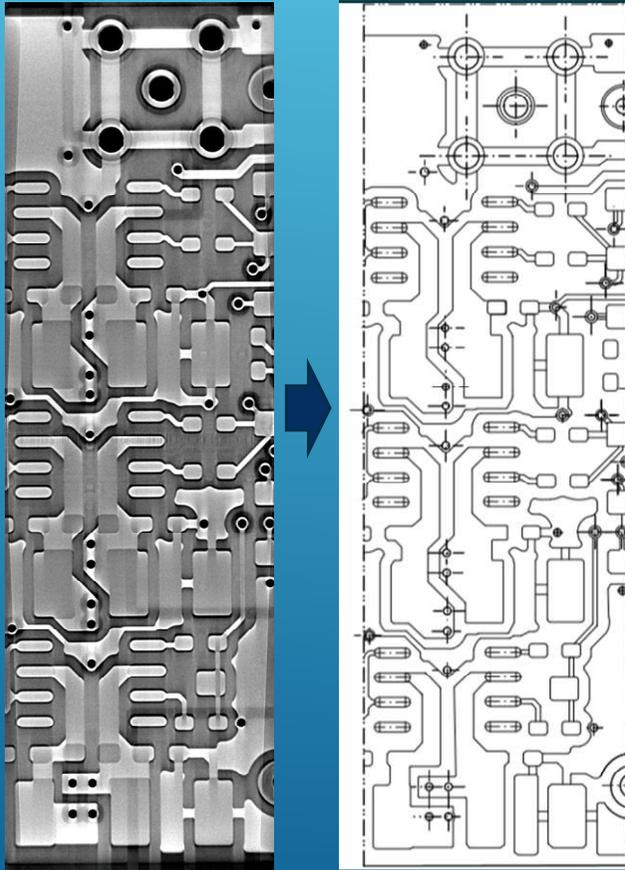
【光学写真画像】

【透過X線画像】

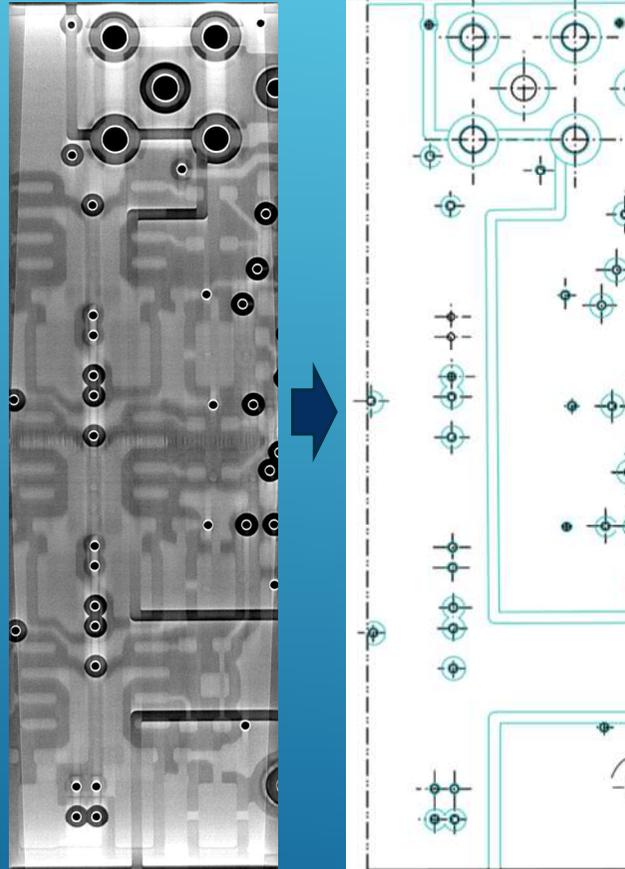


パターン分離画像とCAD図（代表例）

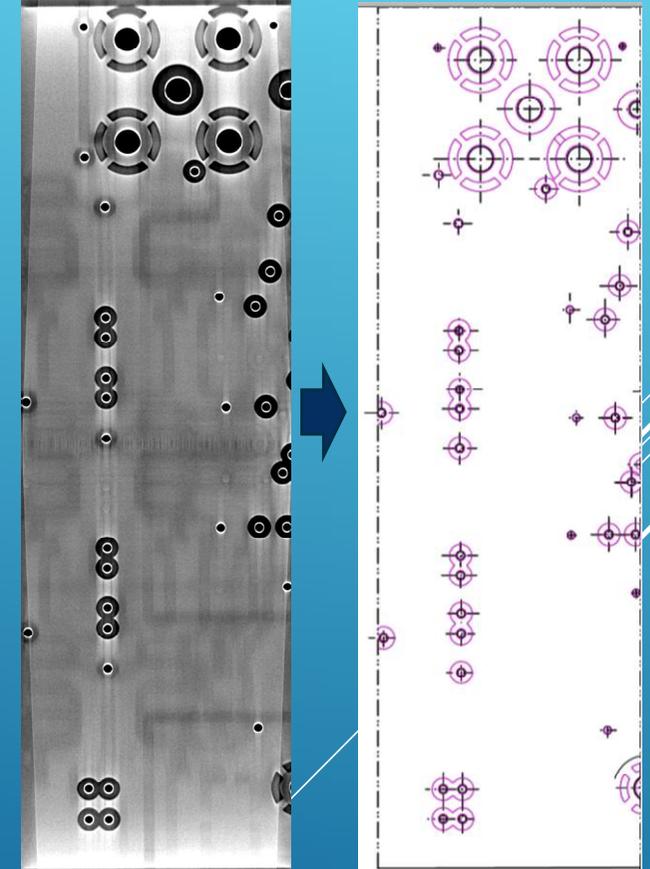
第1層



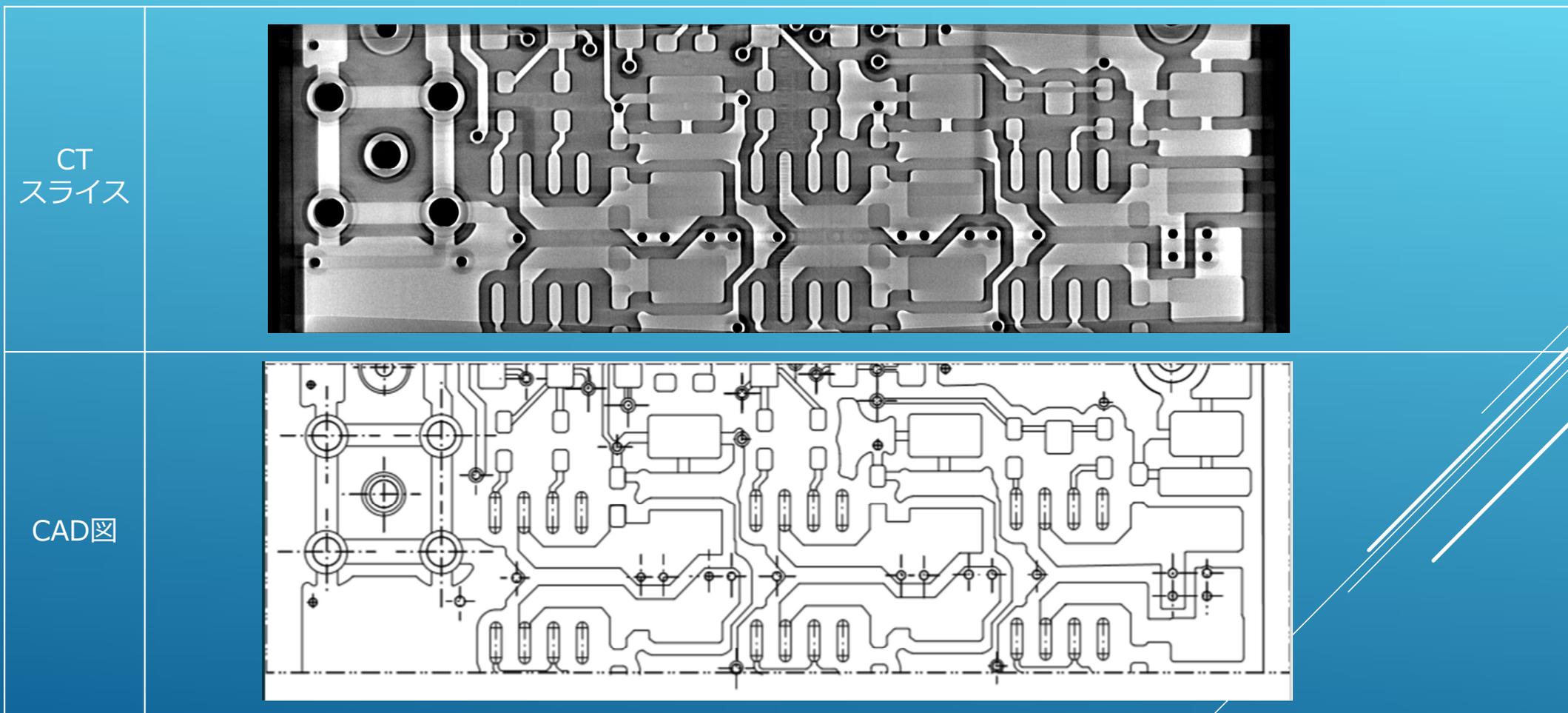
第2層



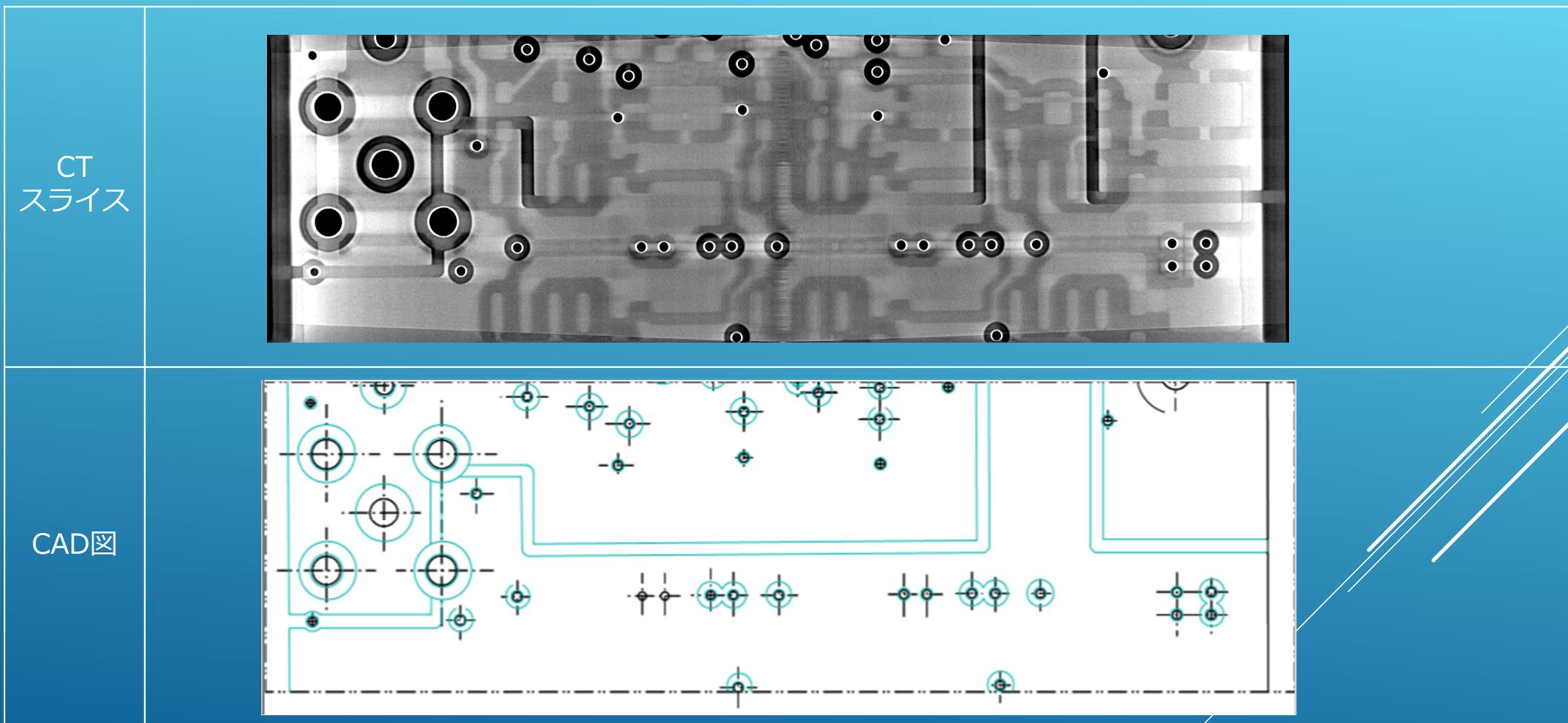
第3層



■ Y2 第1層 CTスライス画像&CAD図



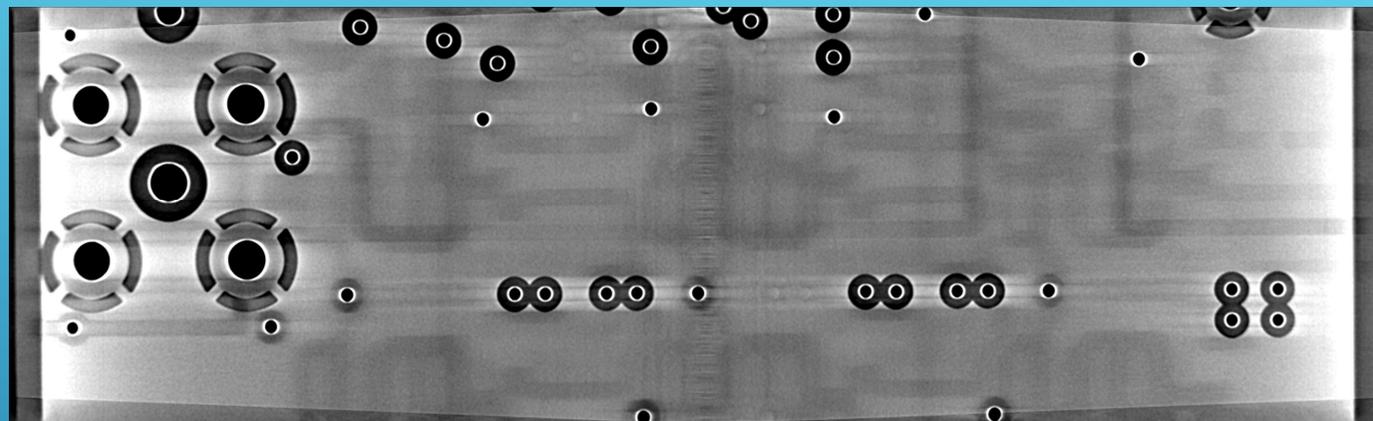
■ Y2 第2層 CTスライス画像&CAD図



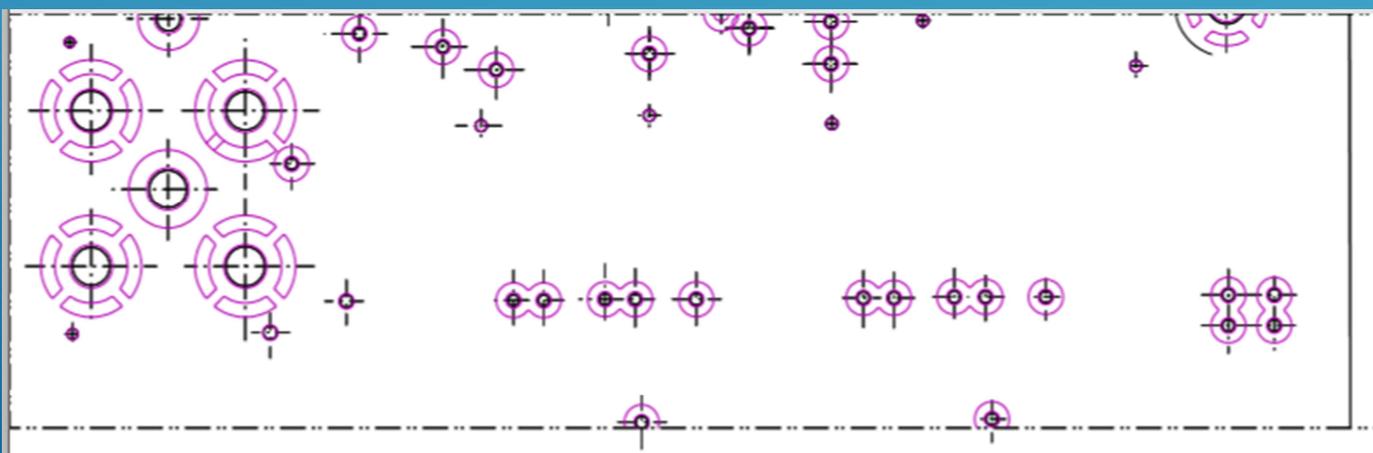
(株)ビームセンス

■ Y2 第3層 スライス画像&CAD図

CT
スライス



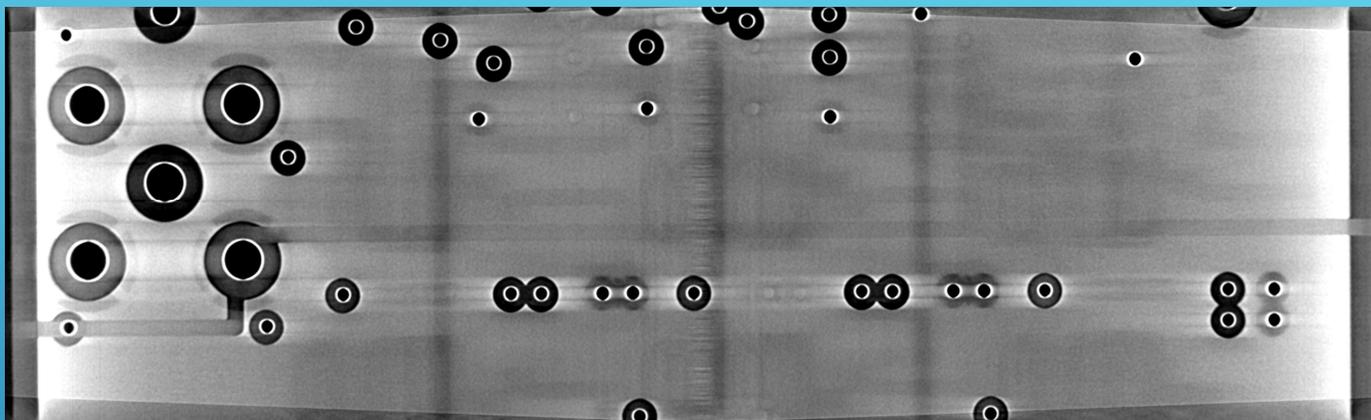
CAD図



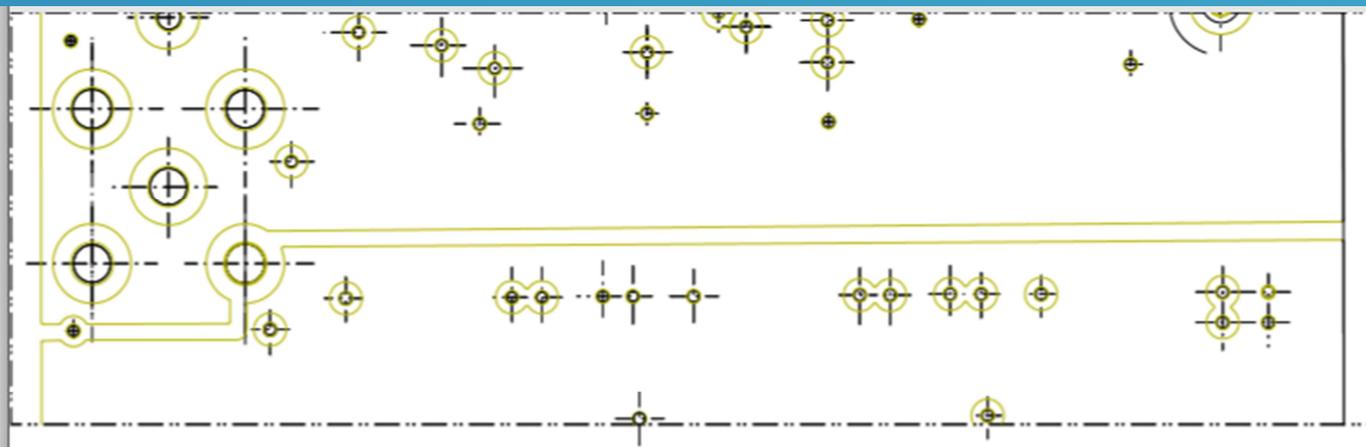
(株)ビームセンス

■ Y2 第4層 スライス画像&CAD図

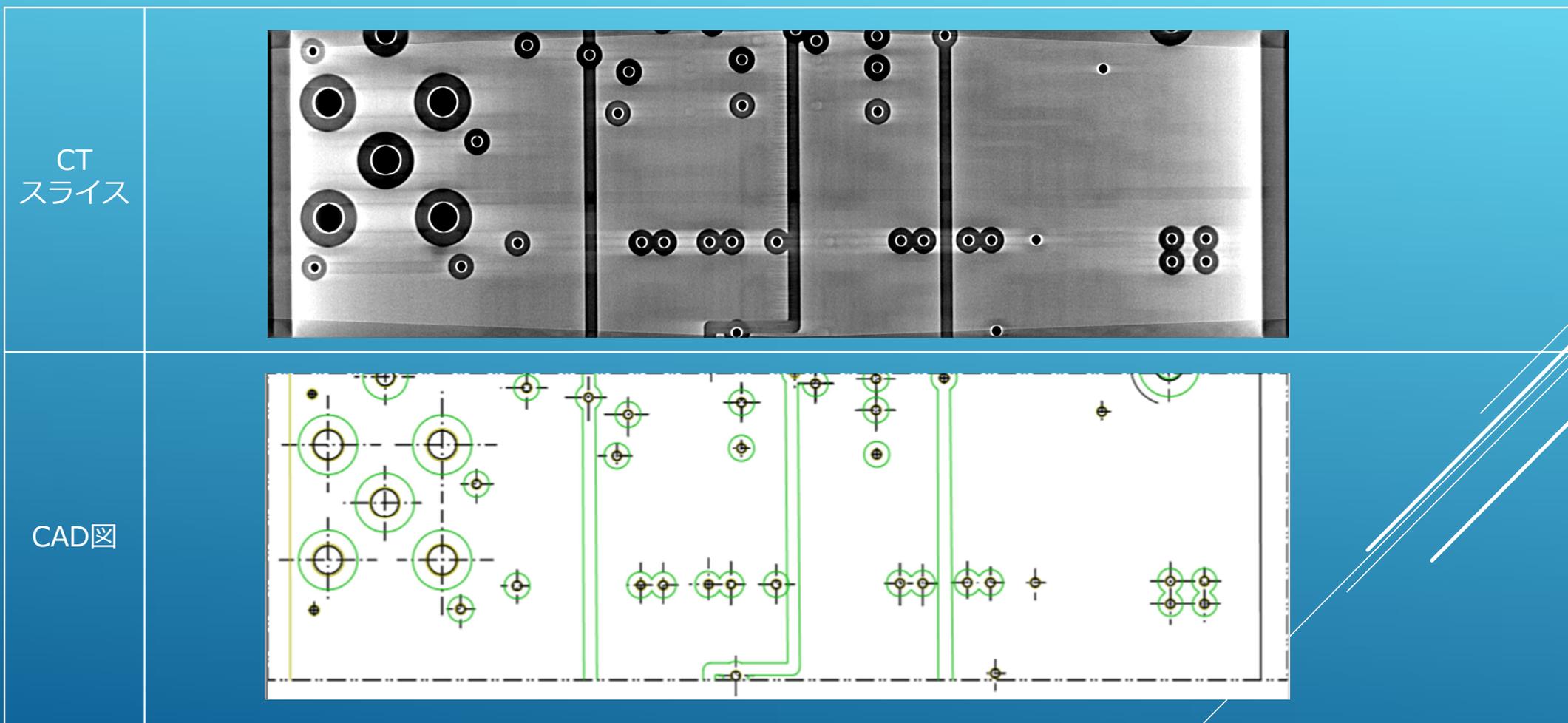
CT
スライス



CAD図

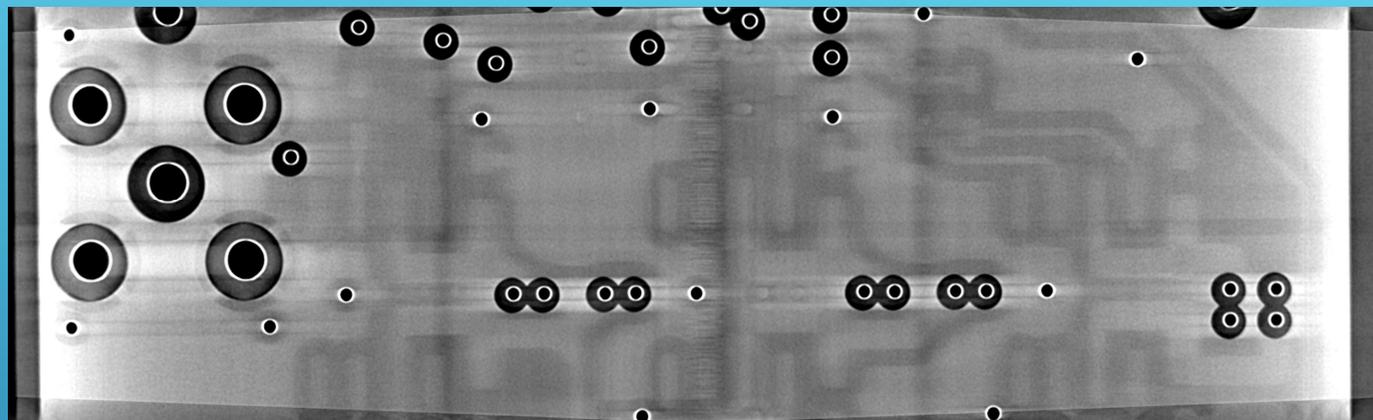


■ Y2 第5層 スライス画像&CAD図

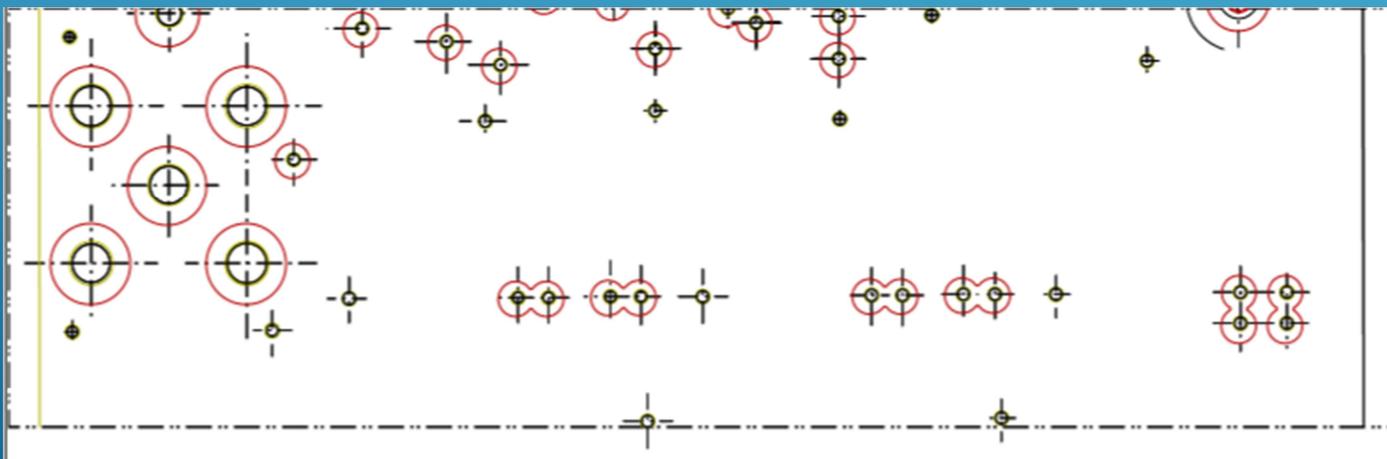


■ Y2 第6層 スライス画像&CAD図

CT
スライス

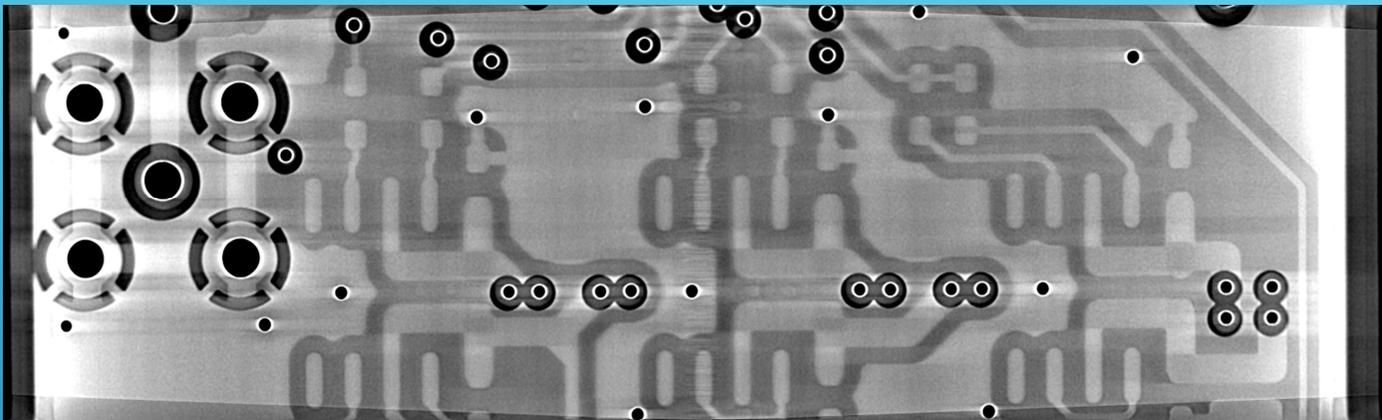
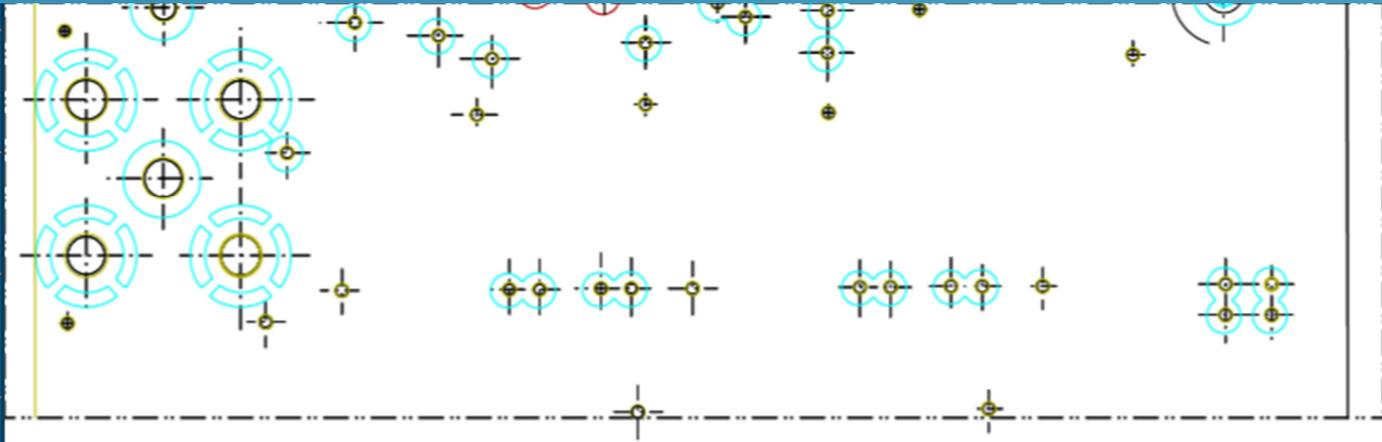


CAD図



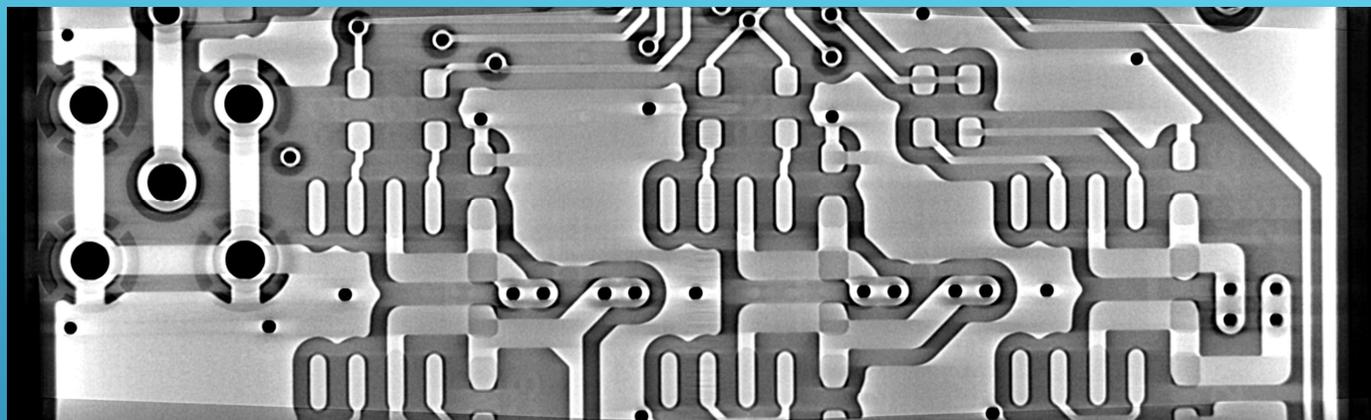
(株)ビームセンス

■ Y2 第7層 スライス画像&CAD図

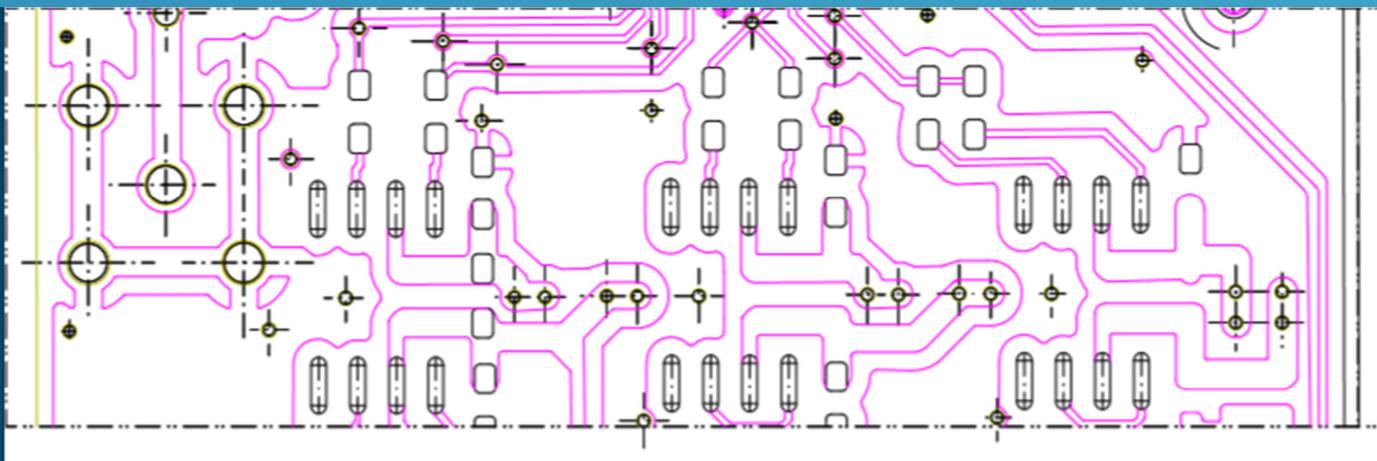
CT スライス	
CAD図	

■ Y2 第8層 スライス画像&CAD図

CT
スライス



CAD図



【お問い合わせ先】

株式会社 ビームセンス

BEAMSENSE CO.,LTD.

〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-19-16

2-19-16 Izumi-cho , Suita City , Osaka 564-0041,Japan

info@beamsense.co.jp